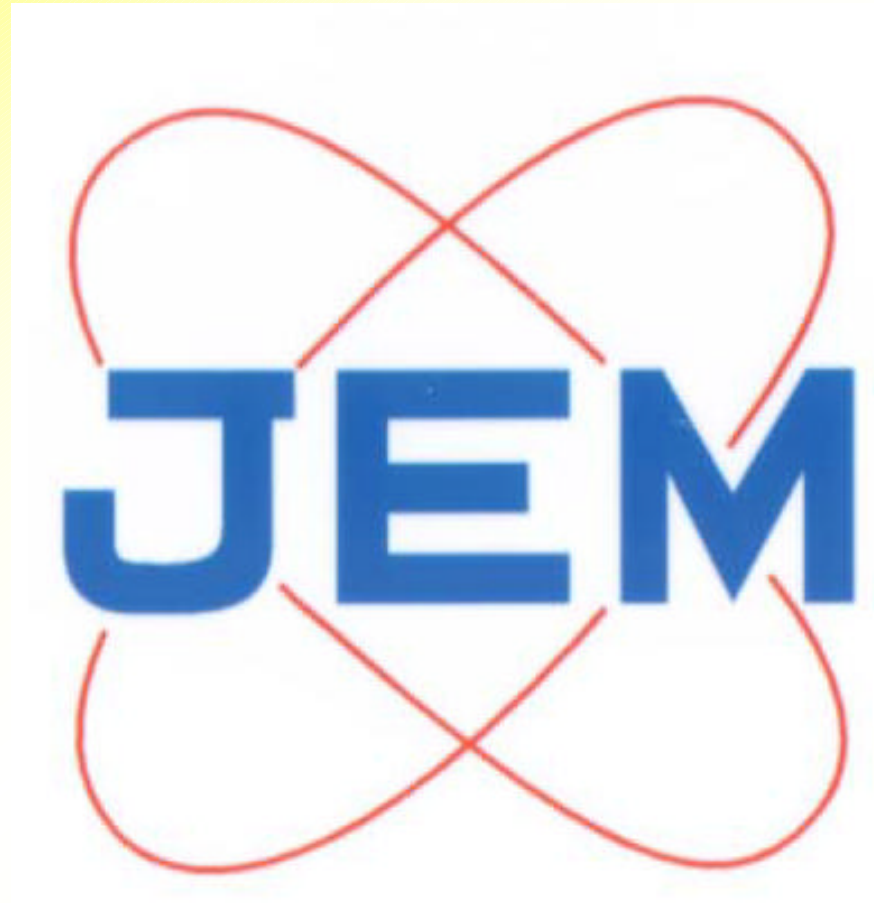


# '04年度事業概要

資料 1



*Probe Card for the Future*

'04中間決算説明会（'04.11.29）<sub>1</sub>

## 将来の見通しに関する記述についての注意

本資料で記述されている業績予想および将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。

そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来の見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

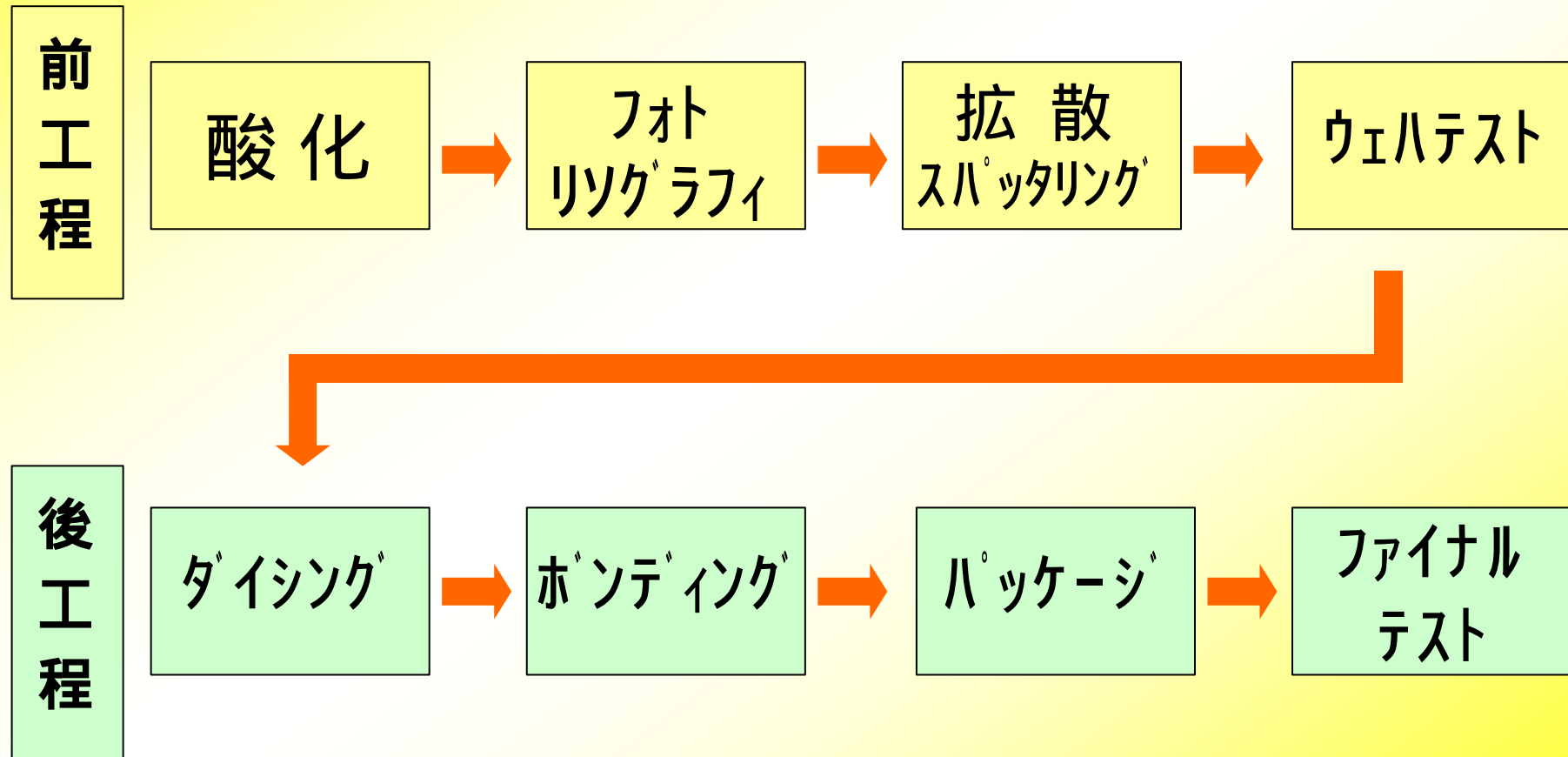


# 部 門 別 製 品 群

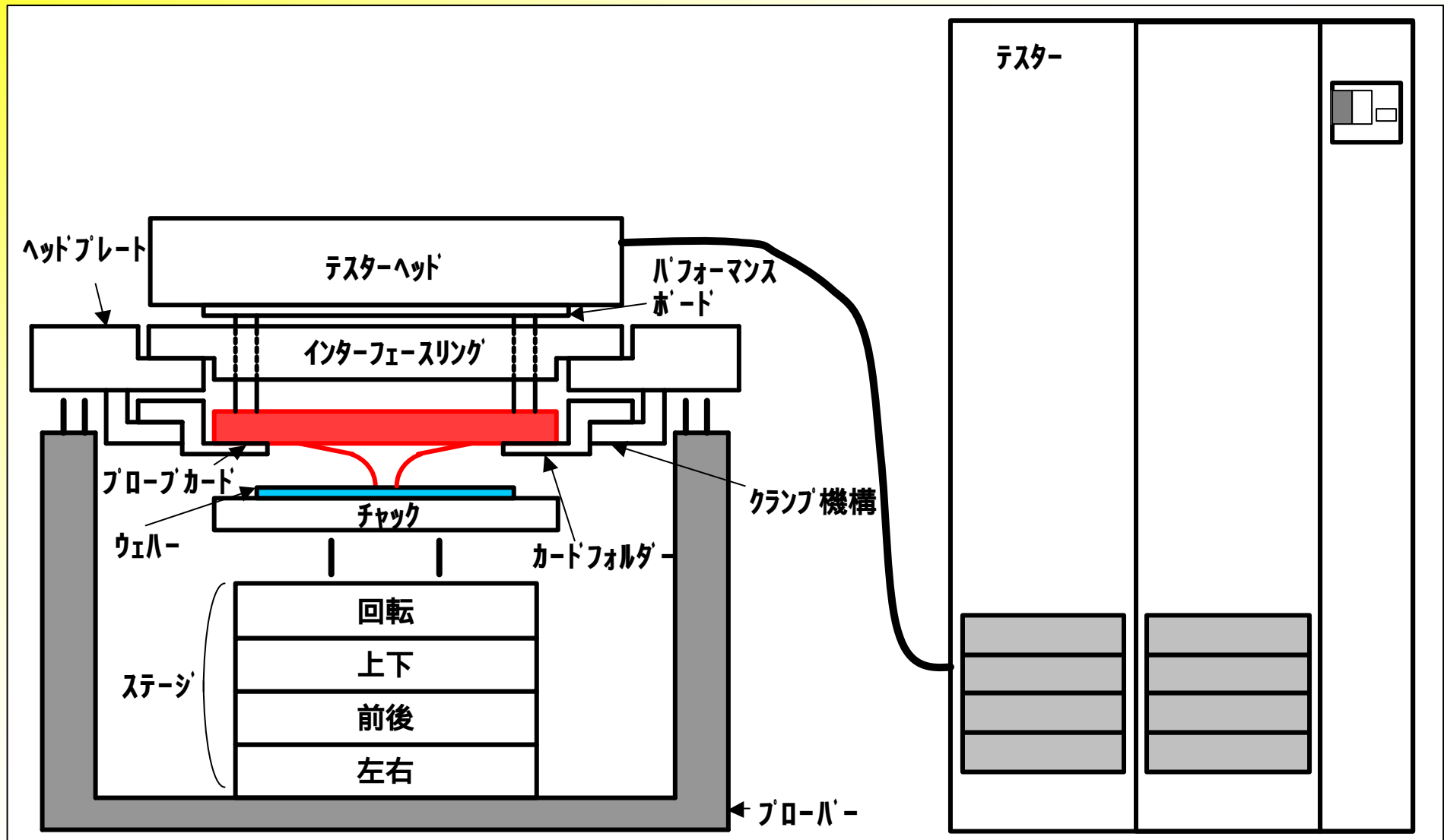
区 分	主 な 製 品
半導体検査用部品	カンチレバー型 (Cタイプ) プローブカード アドバンスド (Vタイプ、Mタイプ) プローブカード
電子管部品	ブラウン管用ヒーター 蛍光文字表示管フィラメント



# 半導体の製造工程

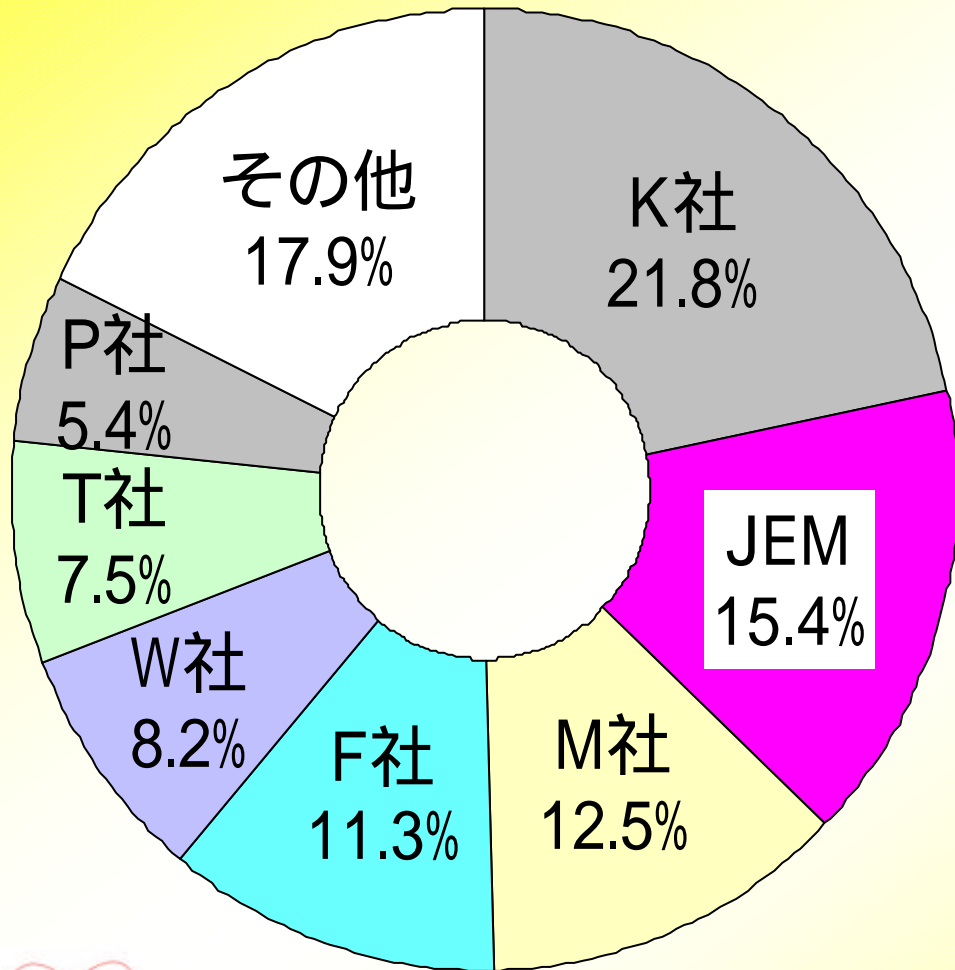


# ウェハーテスト

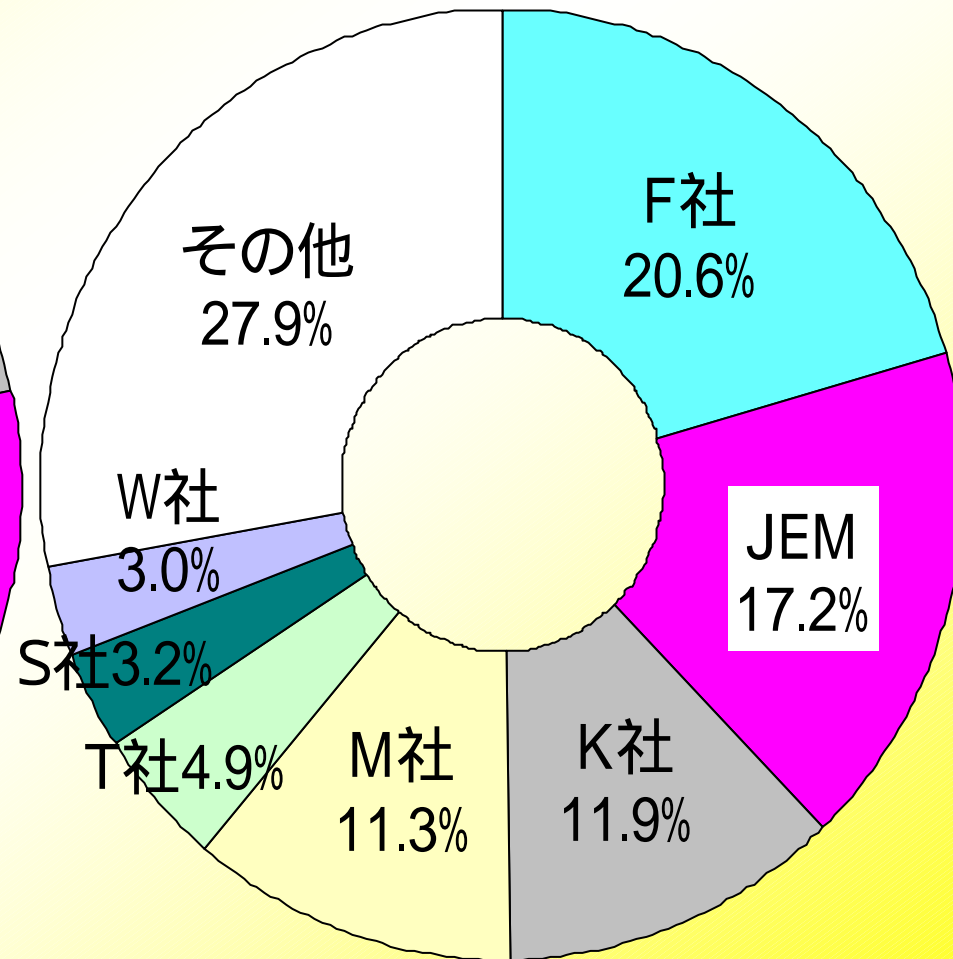


# プローブカードの世界シェア

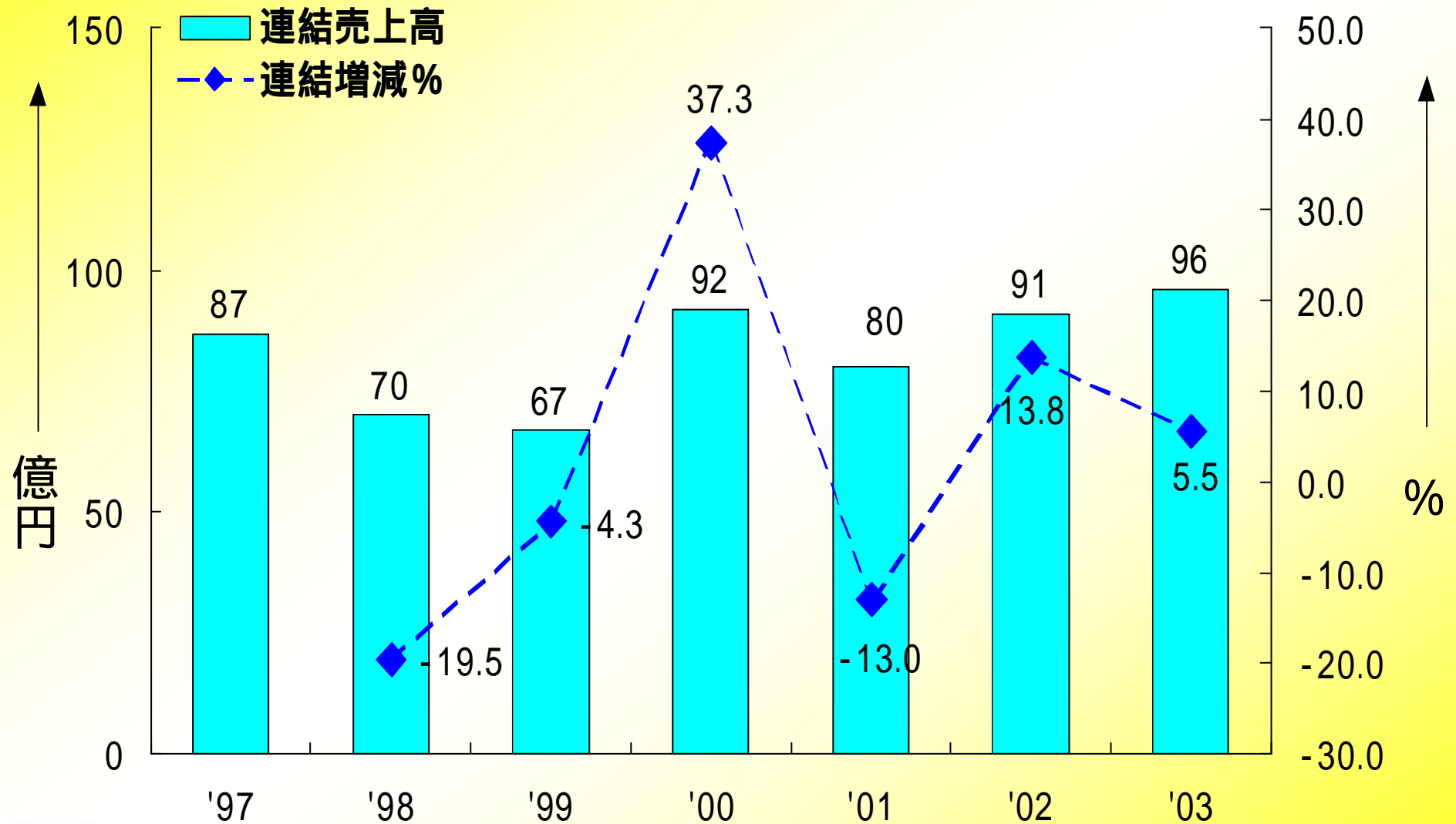
( '00年度 )



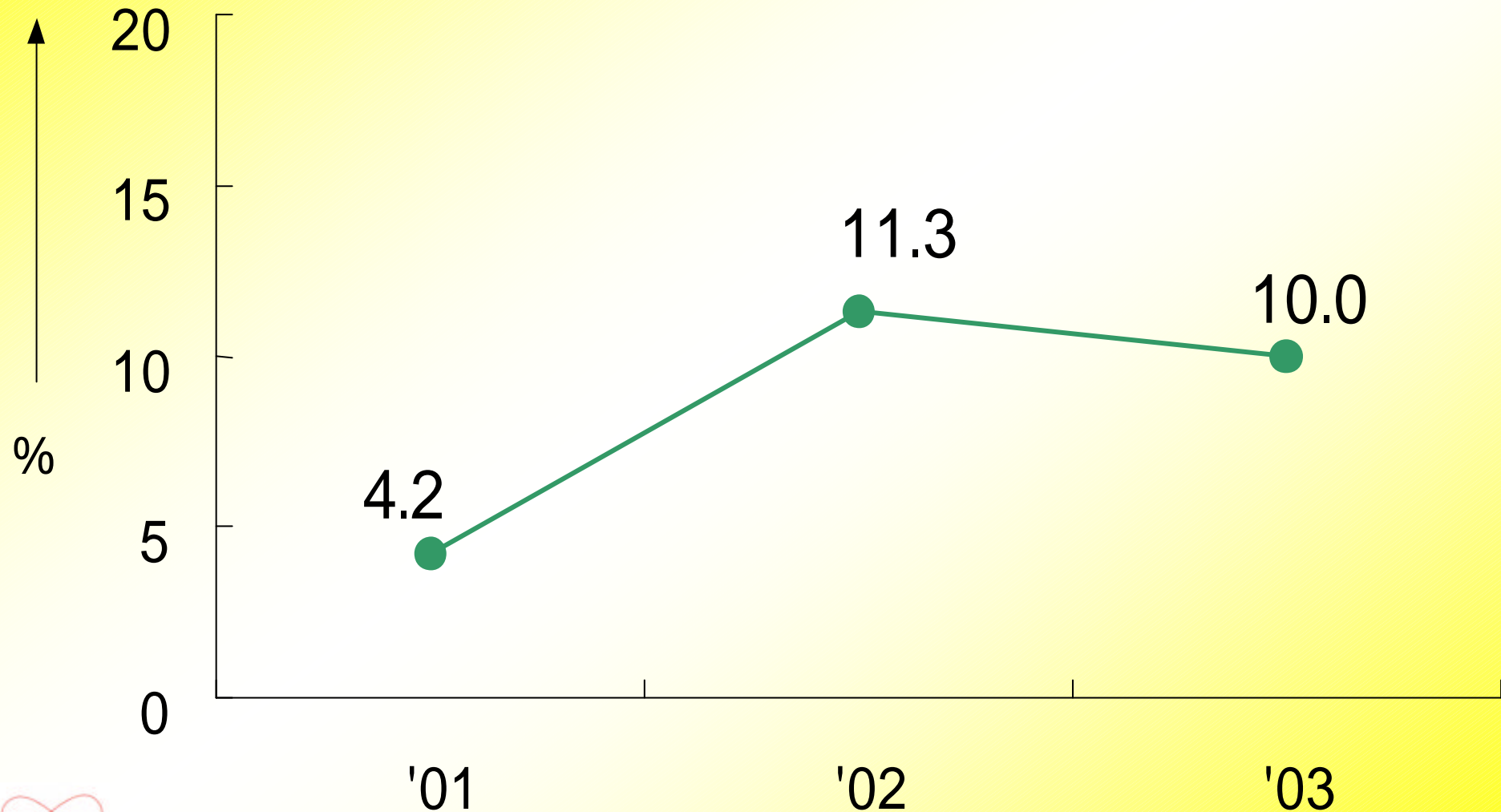
( '03年度 )



# JEM 売上高実績推移

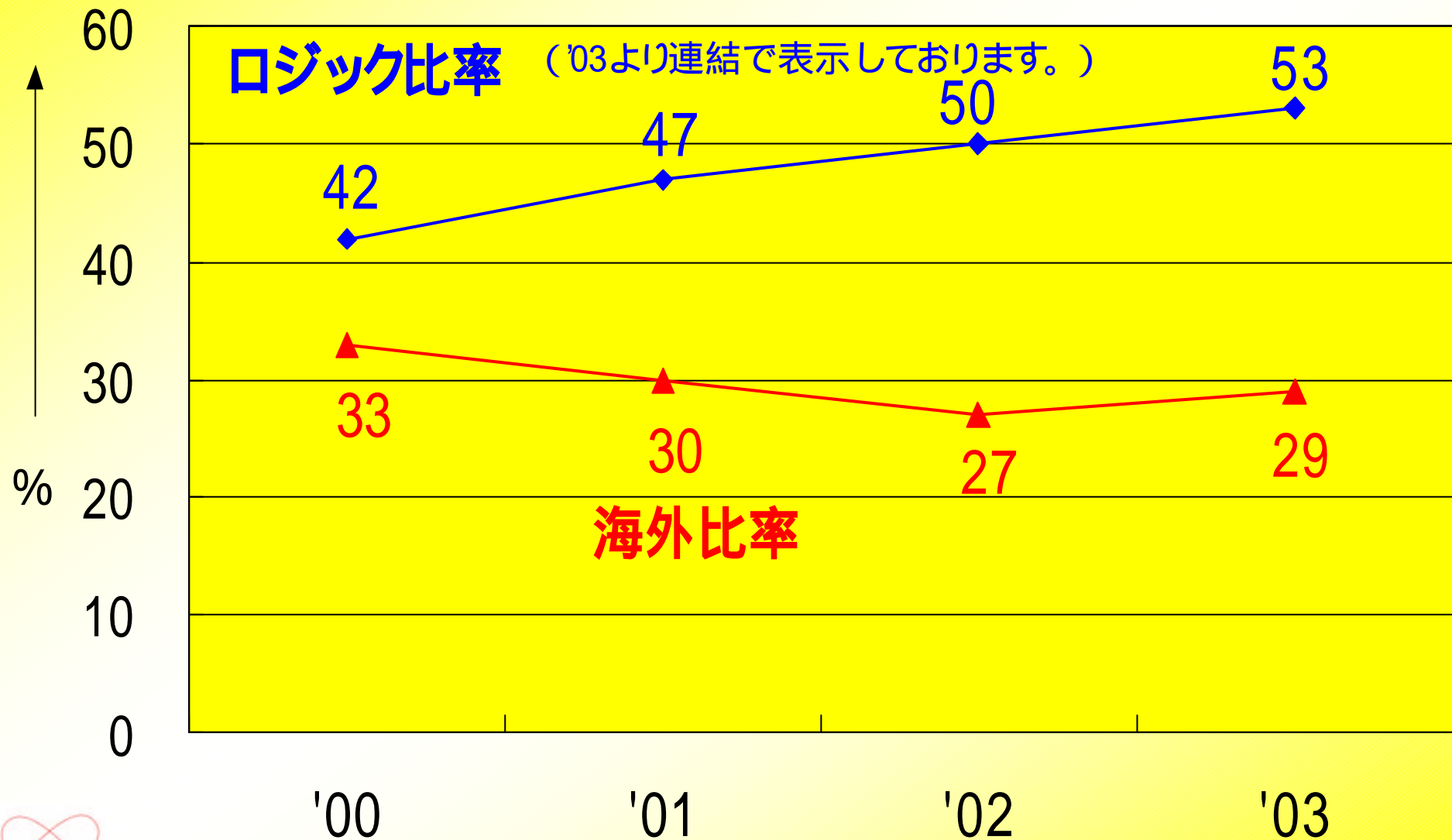


# 株主資本利益率 (ROE)

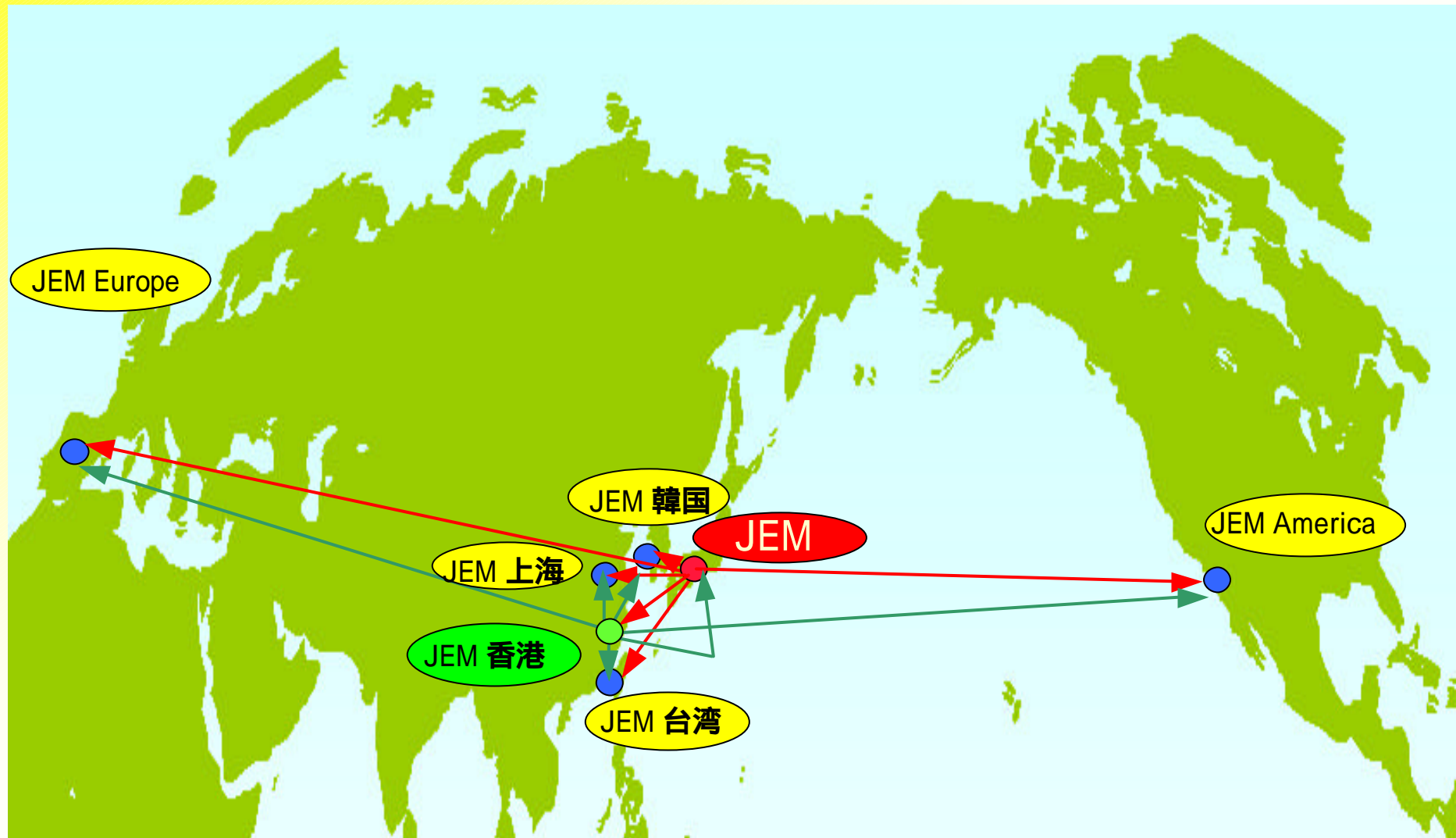




# ロジック比率、海外比率



# JEM 四極体制



# 工場配置

工場	主な製品	主要支援工場	Sub工場
熊本工場	Memory 100% Logic (システムLSI他) 40%	JEM香港 (Shenzhen)	三矢電子 (熊本県)
本社工場	Logic (LCD-Dr.他) 40%	JEM香港 (Shenzhen)	比内時計工業 (秋田県)
静岡工場	Logic (マイコン他) 20%	JEM香港 (Shenzhen)	比内時計工業 (秋田県)

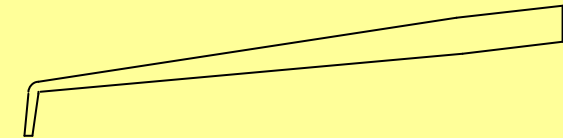
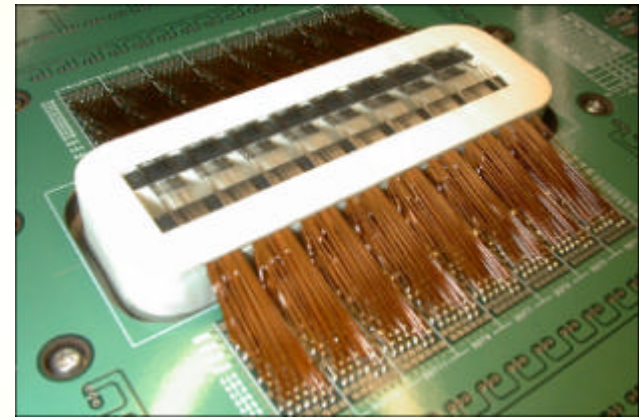
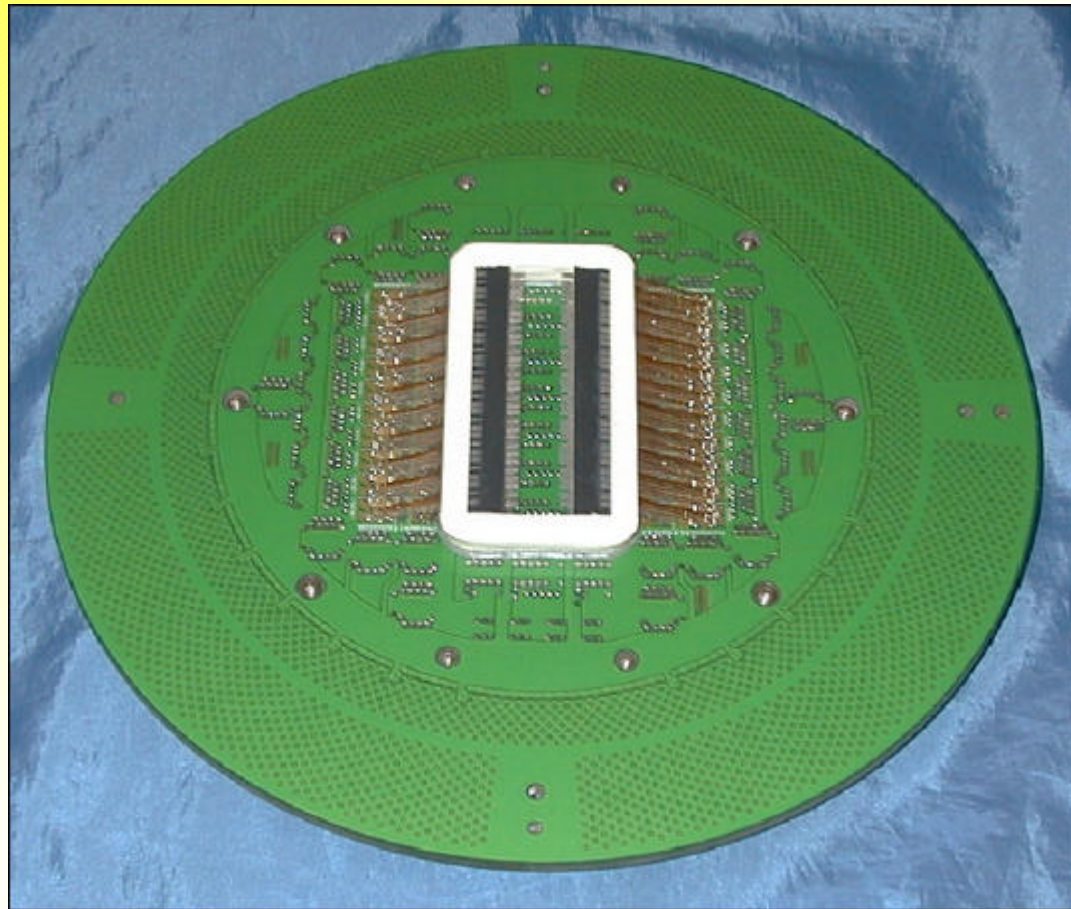


# JEMのPC一覧

	タイプ	シリーズ			
アドバンスHPC	M Type	MA (LCD)	MB (Area Array)	MC (Memory)	MD (New Technology)
	V Type	VC (VCPC)	VH (HAWK)	VS (VSCC)	VP (High Current)
	C Type	CB (Blade)		CE (Epoxy)	

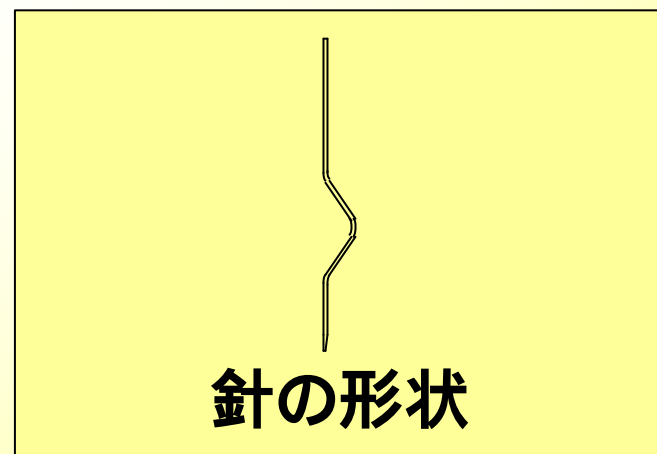
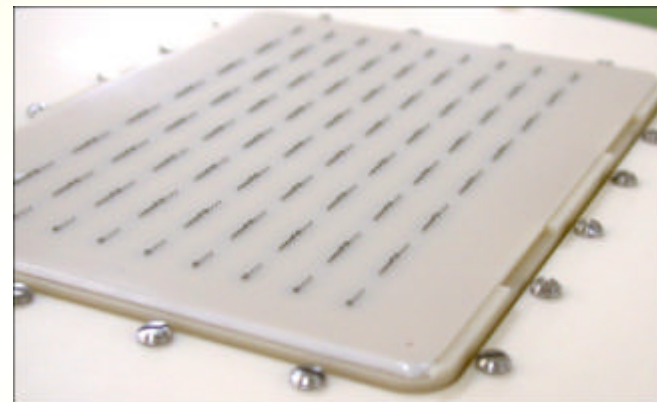
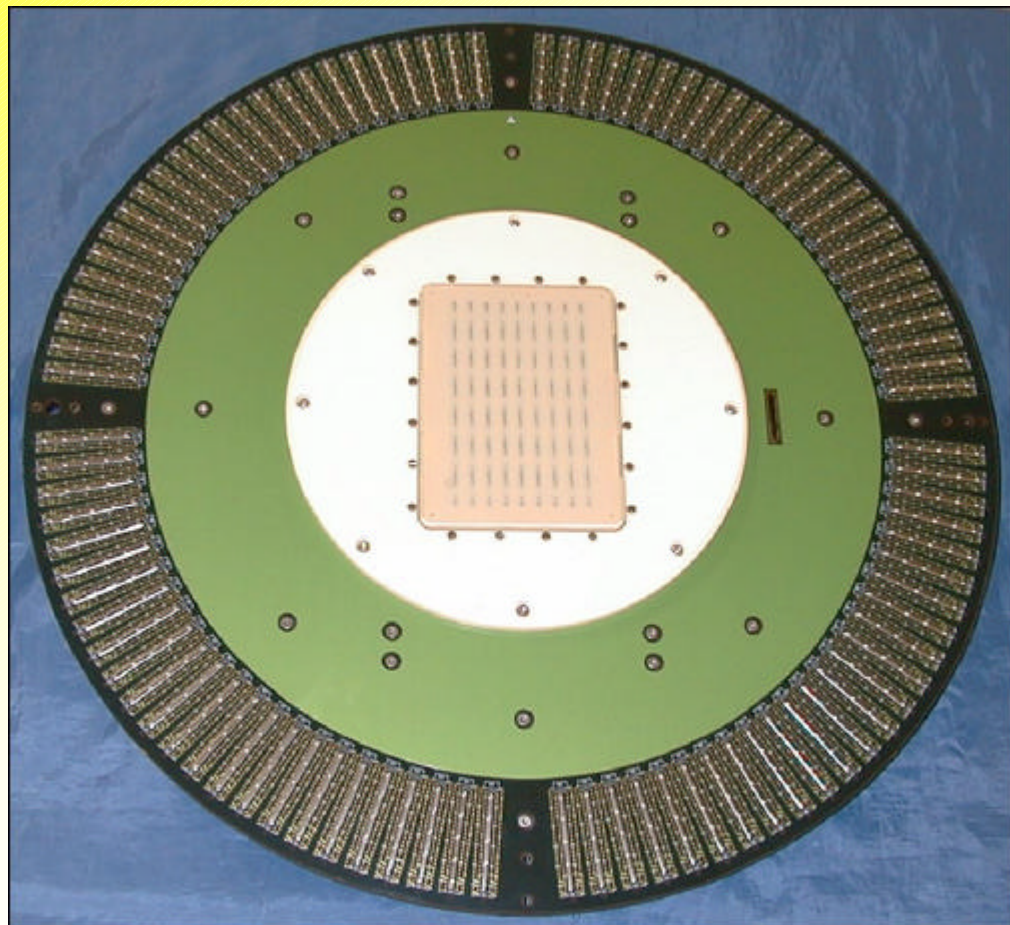


# CE (カンチレバ-型)の外観

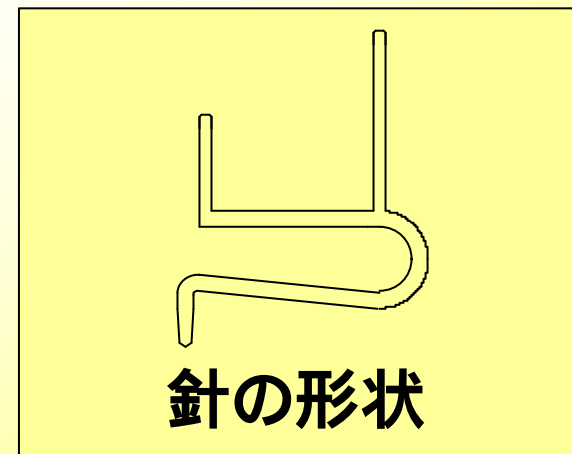
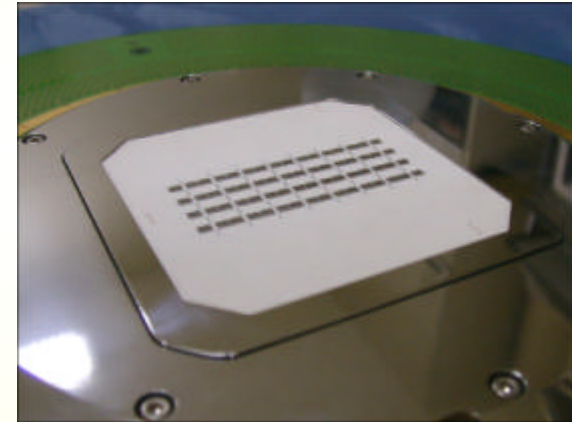
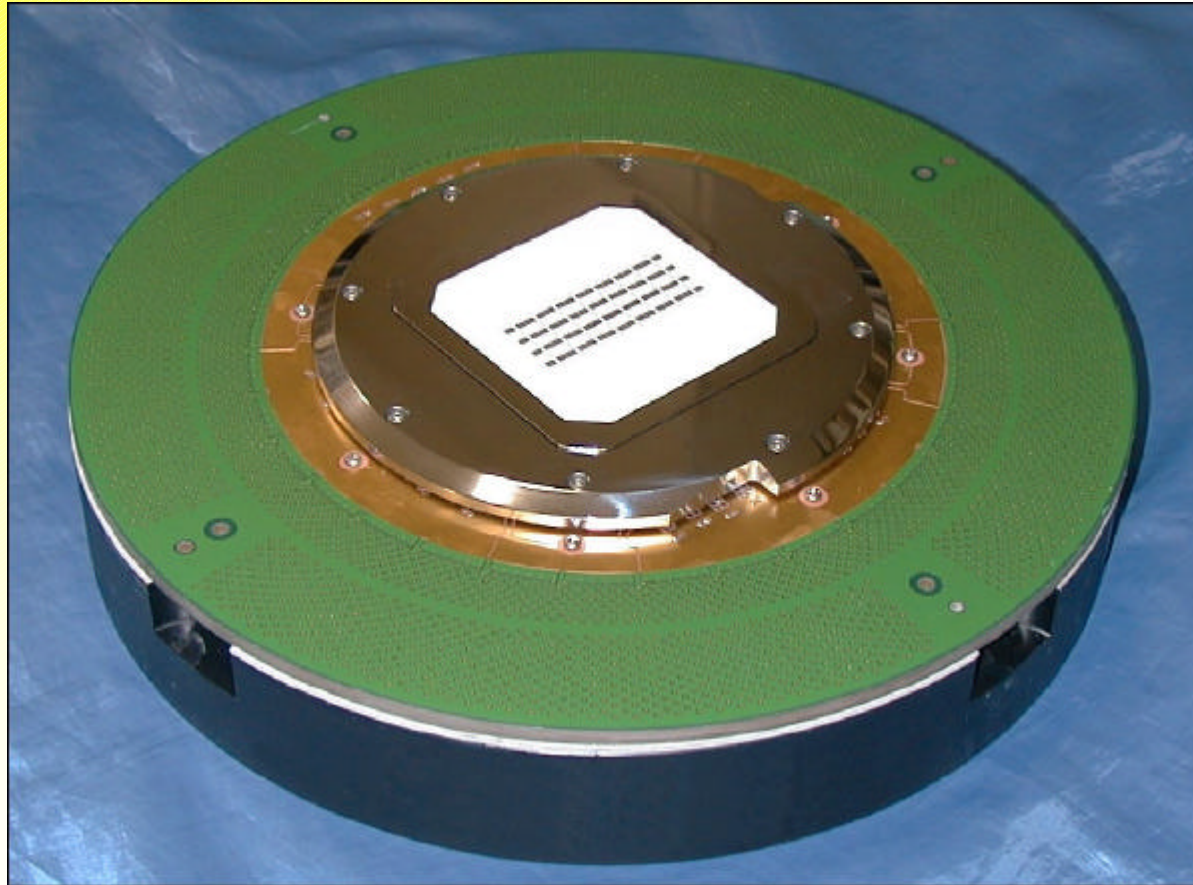


針の形状

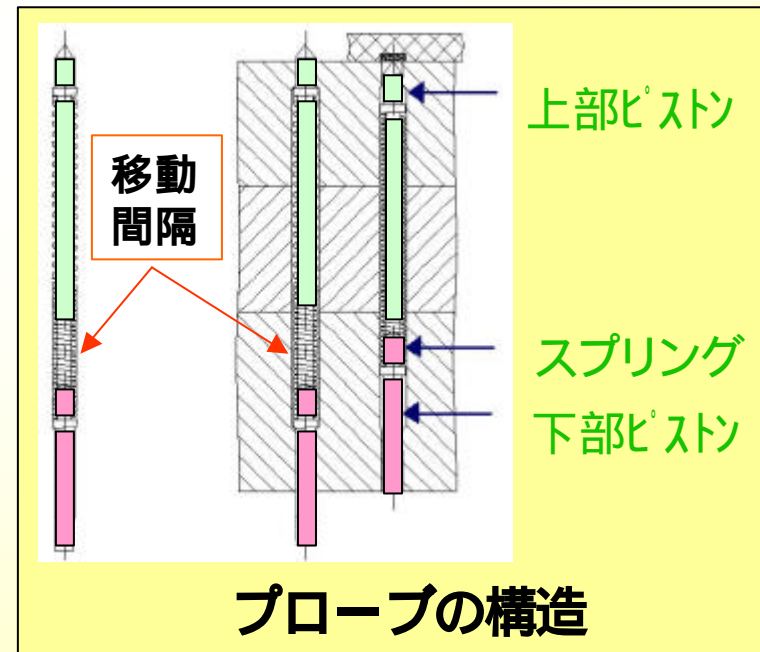
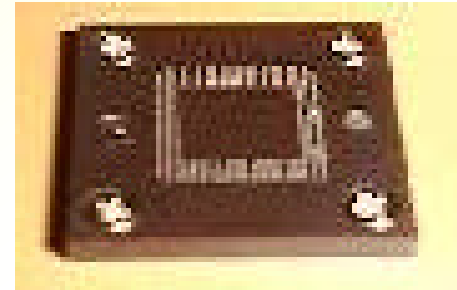
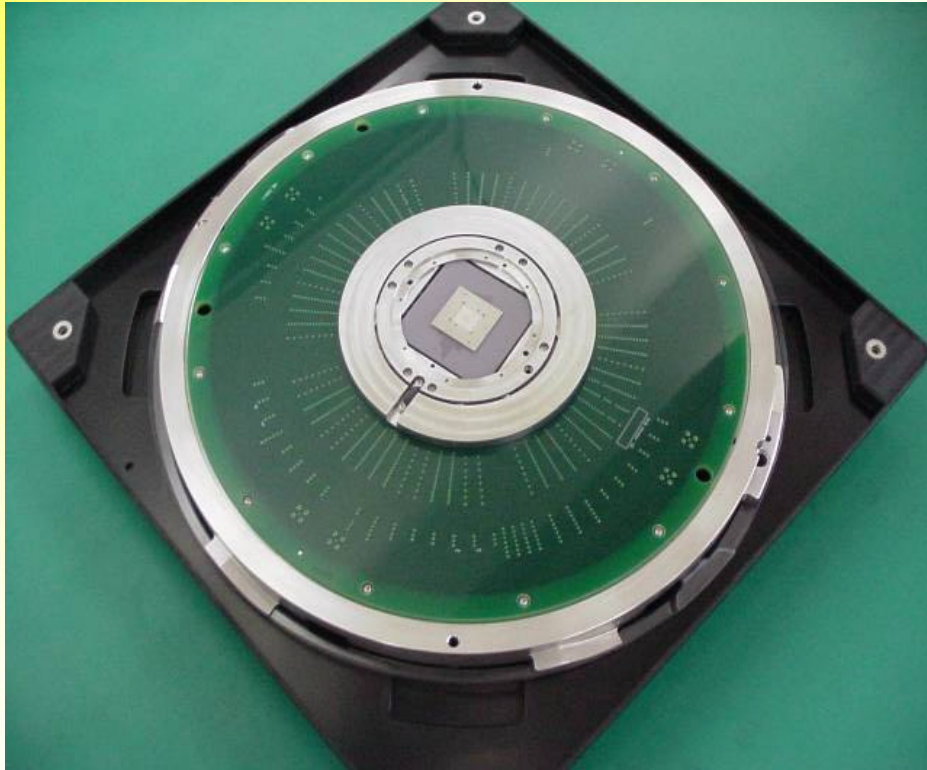
# VC (垂直接触型プローブカード)の外観



# VH (高密度垂直接触型プローブカード)の外観



# VS (垂直スプリング接触型プローブカード)の外観





# 中期計画（'04～'06）の骨子

## Break Through for 2006 !

### 1. 基本戦略

技術力で圧倒的な優位に立つJEMを目指す

### 2. 連結売上高

'06年度 130億円

### 3. 経常利益率

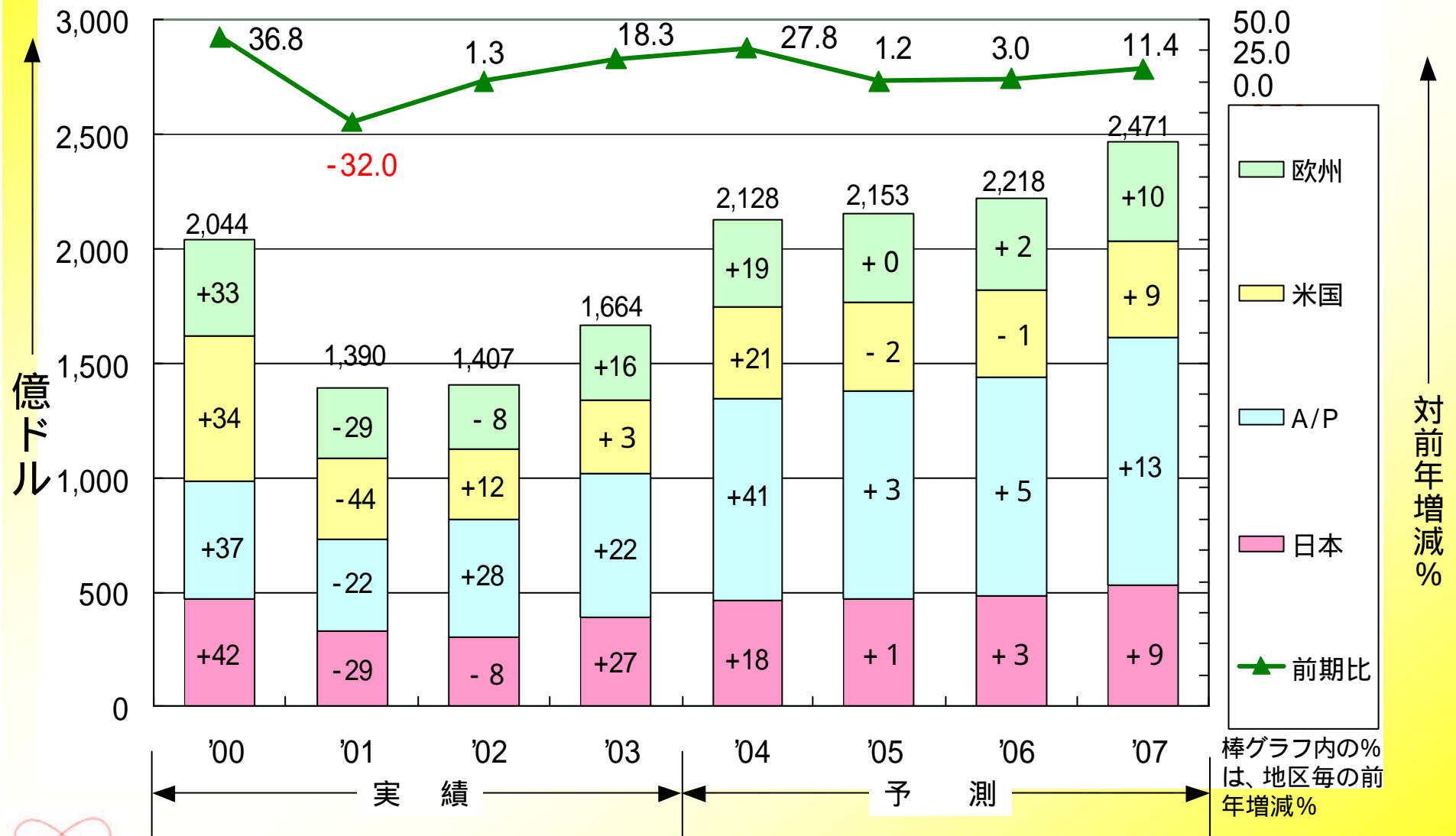
常に10%以上

### 4. プロブカードの世界シェア

20%以上



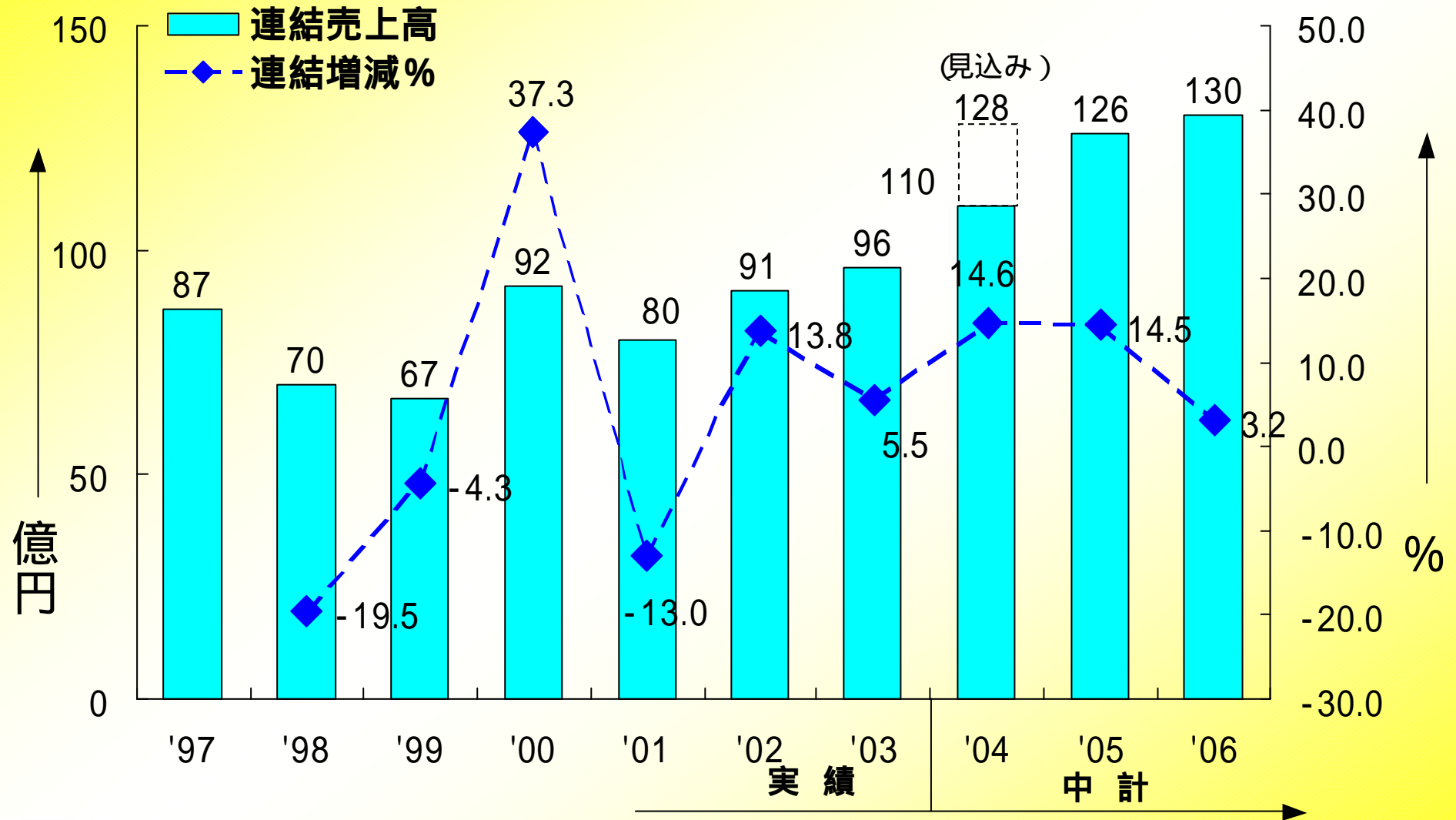
# 世界の地区別 半導体市場規模



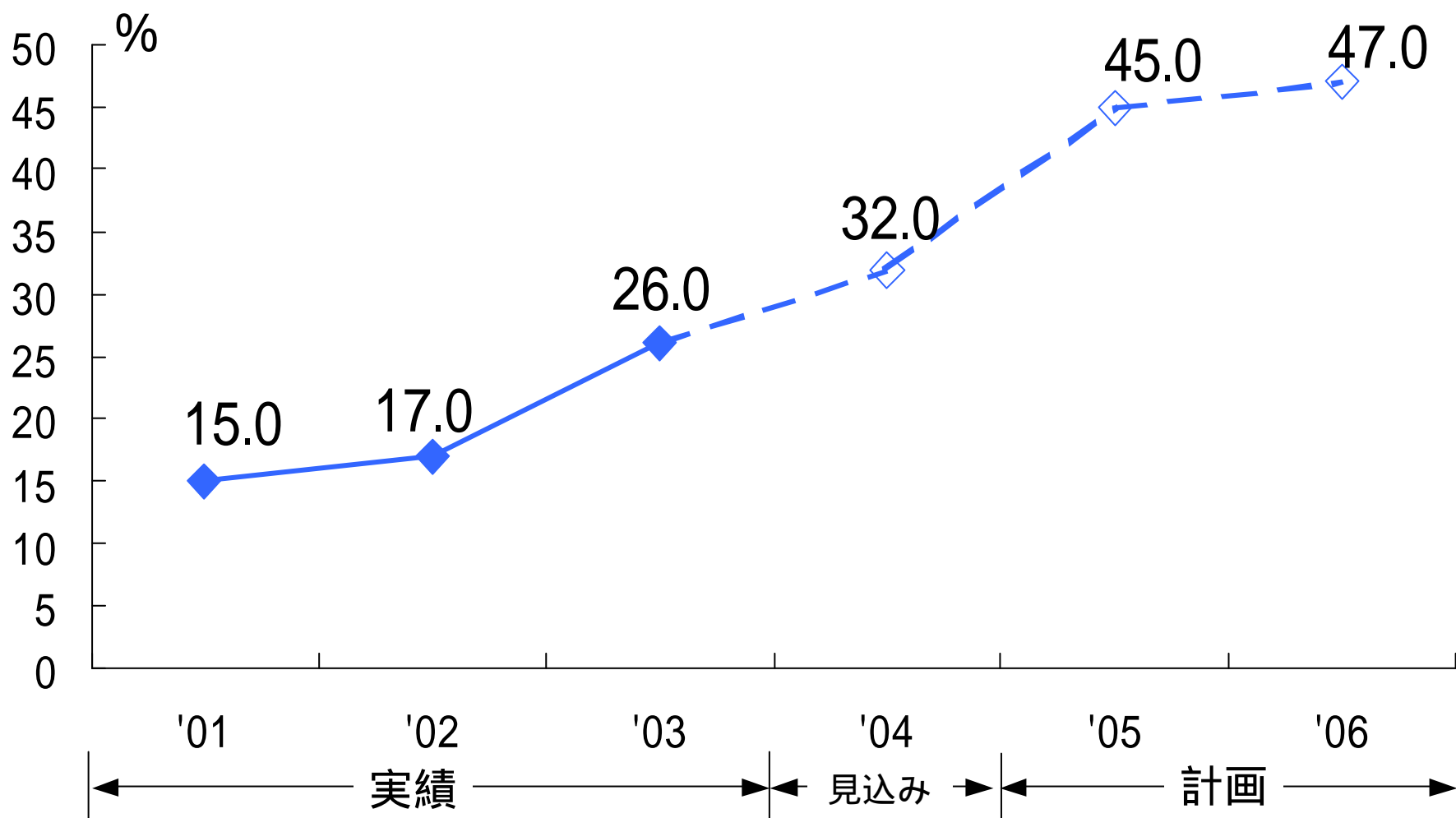
Probe Card for the Future

(出典 :WSTS '04秋季予想) 18

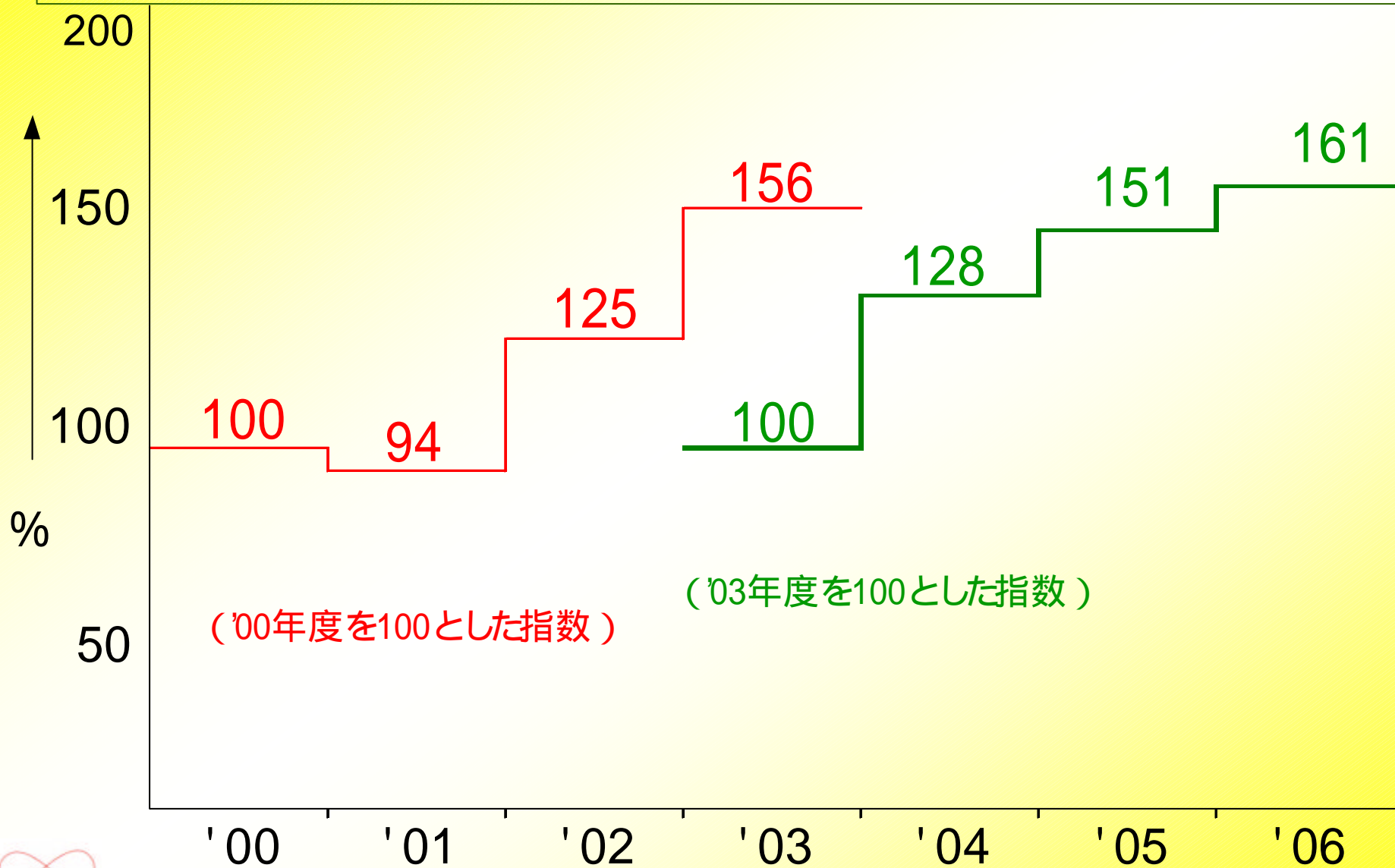
# JEM 売上高実績推移 と中計 ('04 ~ '06)



# JEMアドバンスドプローブカート売上高推移 (VC、VH、VS e.t.c.)



# プローブカード生産ピン数の推移



( '00年度を100とした指数 )

( '03年度を100とした指数 )



# Break Through for 2006!

## 半導体事業方針

1. メモリー      世界トップを目指す  
VCのさらなる市場拡大  
VHの本格量産
2. ロジック      ロジック比率50%の堅持  
システムLSI、マイコン、LCD Dr.別戦略  
オールドエコノミーでの生き残り
3. 海外      売上高比率50%達成  
「MISS-IT」作戦の推進  
( M :Micron      S :ST-Micro )  
  : Intel      :Infre on )  
  S :SMIC      T :TI )



# '04 年度 重点 施策

新たなチャレンジ、そして加速化！

1. メモリ戦略  
VHの収益性向上  
VC・カンチ (Cタイプ)の技術改善
2. ロジック戦略  
オールドエコノミー :コスト1/2の強力推進  
デバイス別営業戦略の明確化
3. 海外戦略  
「MISS- II」作戦  
JEM AMERICA の再建  
JEM 上海の飛躍
4. 新事業  
'04年度計画 売上高 8億円  
パートナーの発掘、具体化



# Samsung Partners' Day 2004



三星電子より

“Best in Value” Supplier Award

を受賞いたしました。

( '04年11月 )



*Probe Card for the Future*



# 2003 Regional Supplier Recognition Award



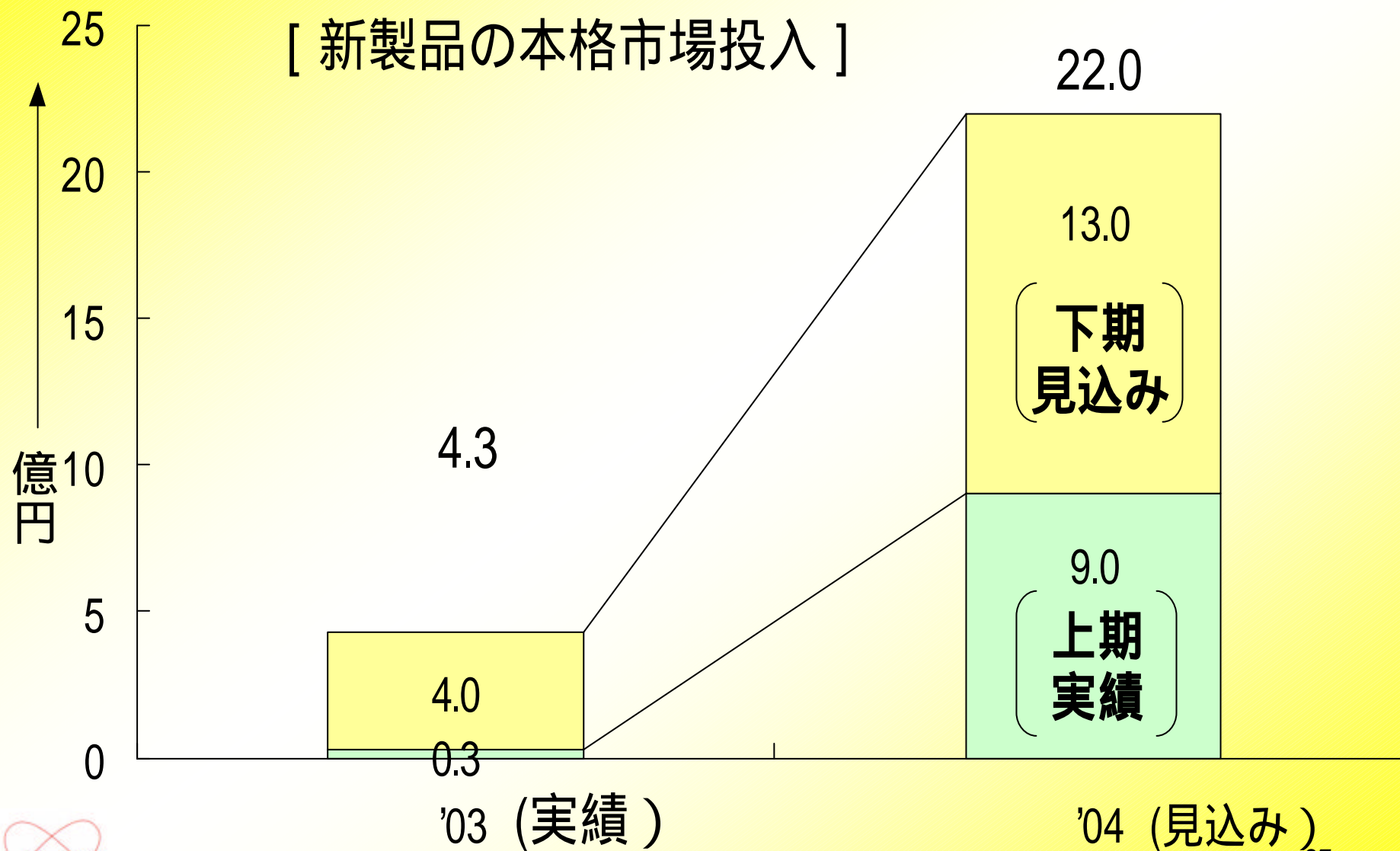
TEXAS INSTRUMENTS より  
“2003 Regional Supplier  
Recognition Award ”  
を受賞いたしました。  
(’04年 6月)

# '04年度上期実績

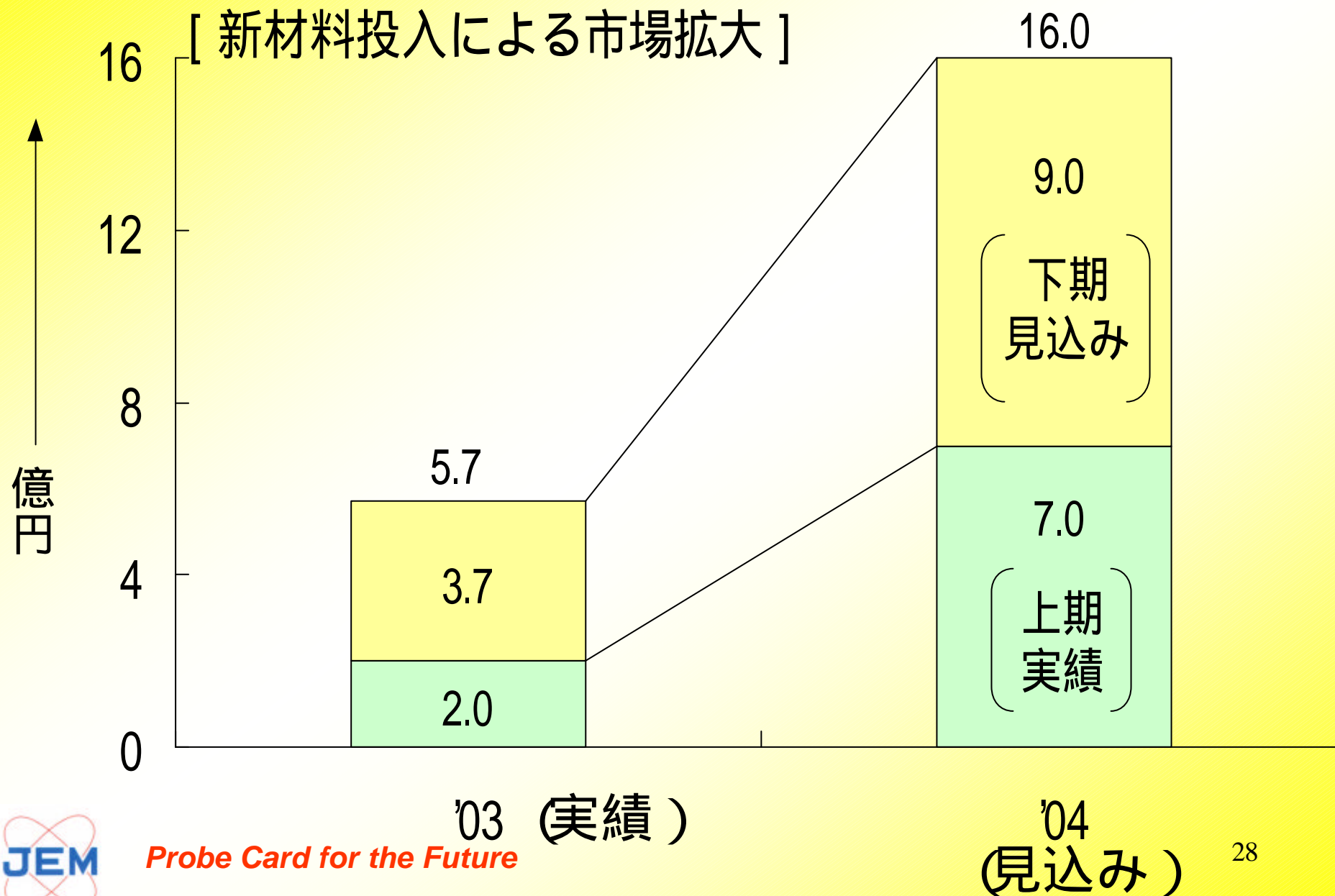
1. メモリー戦略      VHの拡大  
前中間期比 30倍
2. ロジック戦略      LCD Dr の伸長  
前中間期 3倍
3. 海外戦略      JEM AMERICA CORP.の黒字化  
海外売上高比率の伸長  
31%      36%
4. 新事業      パートナーの発掘  
STA社



# VHの売上高



# LCD .Dr用プローブカードの売上高



# Break Through for 2006!

## 開発方針

1. 独自技術を育む基盤確立

- ・ コア技術力の強化

2. Mタイプの市場展開

3. テストのパラダイムシフトへの対応

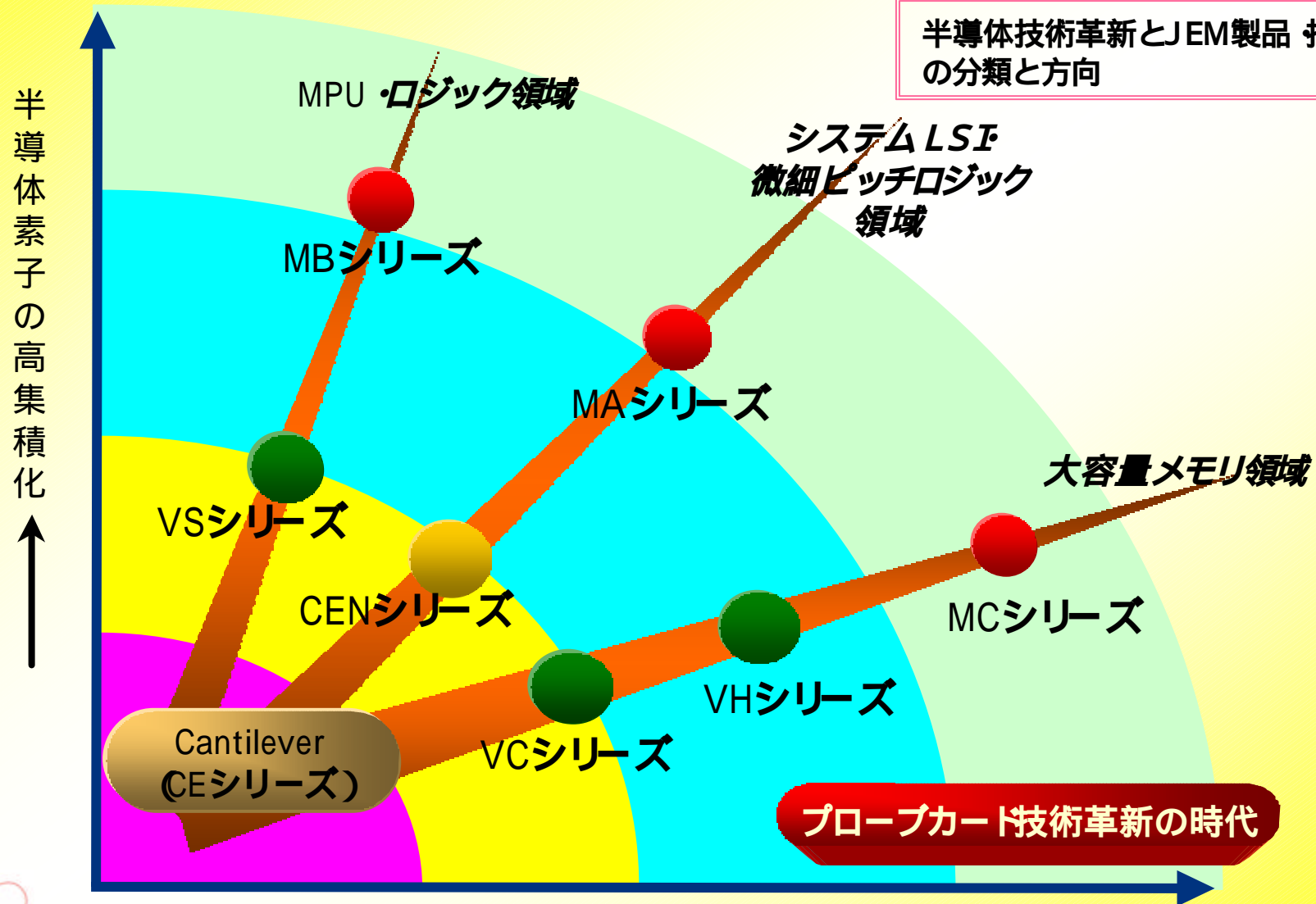
ウエハー一括プロービング技術の確立

インテリジェントプローブカードの具体化



# プローブカードロードマップ

半導体技術革新とJEM製品 技術開発の分類と方向



Probe Card for the Future



半導体テスト技術の革新

# Break Through for 2006!

## 新事業方針

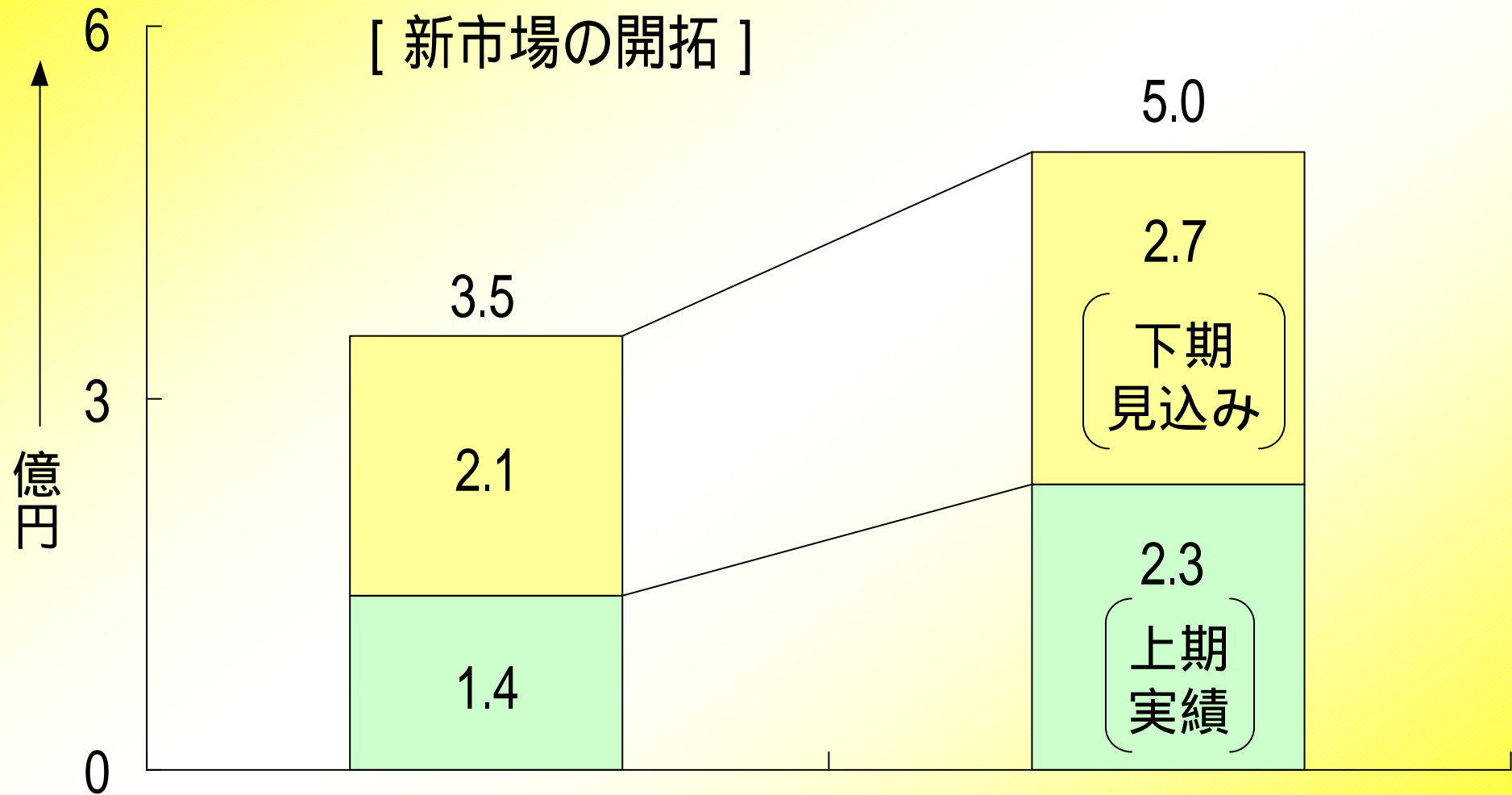
1. 液晶分野への進出
2. RF、パラメトリックの市場開拓
3. 最終テスト領域拡大
4. プローブカードを応用した付加価値製品の創出
5. 高速・微少・極低温・高温分野の拡大

## 電子事業方針

- ・ 利益体質の堅持



# 新事業の売上高





# 新事業の戦略 (パラメトリックプローブカード)

1 .STAr社との業務提携によるパラメトリックプローブカードの新事業開拓

2 .パラメトリックプローブカードの特徴

業界初、ウエハ温度最大  $-40 \sim 150$  での性能保証

業界初、性能保証値への到達時間保証

業界初、リークレベル300 FA の保証



# ISO取得活動

## 1. ISO14001認証取得活動

- ・ '03年度に取得活動を開始
- ・ '04年 9月に認証取得

## 2. ISO9001認証拡大取得

- ・ '04年 4月に本社（営業・開発・資材）  
本社工場、静岡工場、東京営業が取得

